

2022-2028年中国IC封装 行业发展态势与产业竞争格局报告

报告目录及图表目录

北京迪索共研咨询有限公司

www.cction.com

一、报告报价

《2022-2028年中国IC封装行业发展态势与产业竞争格局报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.cction.com/report/202112/259906.html>

报告价格：纸介版8000元 电子版8000元 纸介+电子8500元

北京迪索共研咨询有限公司

订购电话: 400-700-9228(免长话费) 010-69365838

海外报告销售: 010-69365838

Email: kefu@gonyn.com

联系人：李经理

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、说明、目录、图表目录

IC封装，就是指把硅片上的电路管脚，用导线接引到外部接头处，以便与其它器件连接。封装形式是指安装半导体集成电路芯片用的外壳。它不仅起着安装、固定、密封、保护芯片及增强电热性能等方面的作用，而且还通过芯片上的接点用导线连接到封装外壳的引脚上，这些引脚又通过印刷电路板上的导线与其他器件相连接，从而实现内部芯片与外部电路的连接。因为芯片必须与外界隔离，以防止空气中的杂质对芯片电路的腐蚀而造成电气性能下降。

2019年第一季度全球半导体市场同比下降5.5%。受到全球半导体产业下滑影响，我国集成电路行业2019年一季度增速大幅下降。根据调查数据统计，2019年一季度我国集成电路产业销售额1274亿元，同比增长10.5%，增速同比下降了10.2个百分点，环比下降了10.3个百分点；其中封装测试业销售额423亿元，增速下降幅度最大，同比仅增长5.1%。2019年第二季度我国集成电路产业销售额1774.2亿元，同比增长14.6%，环比增长39.3%；其中封装测试业销售额599.1亿元，同比增长5.9%，环比增长41.6%。二季度集成电路产业与封测产业景气度回升，环比增速接近40%，供需调整接近尾声。随着5G商用、半导体与AI技术融合对数据中心需求的大幅增加、AI与IoT技术融合对智能终端产品的不断革新、存储器需求的恢复增长、汽车电子对高可靠性集成电路产品需求的提高，预计2019年下半年半导体封测行业将逐步回暖。

2011-2019年我国IC封装测试业的市场规模及预测 中企顾问网发布的《2022-2028年中国IC封装行业发展态势与产业竞争格局报告》共九章。首先介绍了中国IC封装行业市场发展环境、IC封装整体运行态势等，接着分析了中国IC封装行业市场运行的现状，然后介绍了IC封装市场竞争格局。随后，报告对IC封装做了重点企业经营状况分析，最后分析了中国IC封装行业发展趋势与投资预测。您若想对IC封装产业有个系统的了解或者想投资中国IC封装行业，本报告是您不可或缺的重要工具。 本研究报告数据主要采用国家统计局，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录：第一章 IC封装产业相关概述第一节 IC封装简介第二节 IC封装类型简介一、SOP封装二、QFP与LQFP封装三、FBGA四、TEBGA五、FC-BGA六、WLCSP第三节 明日之星——TSV封装一、TSV简介二、TSV与SoC三、TSV产业与市场 第二章 世界IC封装所属行业运行状况分析第一节 世界IC封装业所属行业运行环境分析第二节 世界IC封装所属行业运行现状综述

随着芯片制造过程中先进制程的不断提高以及研发、设备费用投入占比逐步攀升，半导体芯片行业逐步从IDM模式向代工制造模式发展。

2018年全球IC封装测试业在存储、车载芯片与通讯封测需求的带动下小幅增长，2018年销

售规模成长1.4%，销售额达到525亿美元。全球移动通信电子产品、高性能计算芯片(HPC)、汽车电子、物联网(IOT)以及5G等产品需求上升、高I/O数和高整合度先进封装迅速发展是推动IC封装测试市场上升的主要原因，预计2019年全球IC封测业市场增速约1.0%。2011-2019年全球IC封装测试业的市场规模及预测一、IC封装特点分析二、IC封装业技术分析三、IC封装业动态分析第三节 世界IC封装重点企业运行分析一、英特尔（Intel）二、IBM三、超微四、英飞凌（Infineon）第四节 2022-2028年世界IC封装业趋势探析 第三章 中国IC封装行业市场发展环境解析第一节 中国宏观经济环境分析一、中国GDP分析二、中国汇率调整分析三、中国工业发展形势分析第二节 中国IC封装市场政策环境分析一、电子产业振兴规划解读二、内需拉动业，IC业政策与整合是关键三、相关行业政策及对IC封装产业的影响第三节 中国IC封装市场技术环境分析一、高端IC封装技术二、中高端IC封装技术有所突破三、IC封装基板技术分析 第四章 2015-2019年中国IC封装相关所属行业数据监测分析第一节 2015-2019年中国集成电路制造所属行业发展分析一、2017年中国集成电路制造所属行业发展概况二、2018年中国集成电路制造所属行业发展概况三、2019年中国集成电路制造所属行业发展概况第二节 2015-2019年中国集成电路制造所属行业规模分析一、企业数量增长分析二、资产规模增长分析三、销售规模增长分析四、利润规模增长分析第三节 2015-2019年中国集成电路制造所属行业结构分析一、企业数量结构分析二、资产规模结构分析三、销售规模结构分析四、利润规模结构分析第四节 2015-2019年中国集成电路制造所属行业成本费用分析一、销售成本统计二、主要费用统计第五节 2015-2019年中国集成电路制造所属行业运营效益分析一、偿债能力分析二、盈利能力分析三、运营能力分析 第五章 中国IC封装产业运行新形势透析第一节 中国IC封装产业运行综述一、大陆IC封装企业的分布及其特点二、IC封装测试业外资独占鳌头三、IC封装向高端技术迈一步四、形成封装及自主品牌终端产业链第二节 中国IC封装产业变局分析一、IC封装业稳步发展，但产值比重有所下降二、产业格局外企主导，行业竞争日益激烈三、封装技术更新加快，国内水平显著提高第三节 中国IC封装业面临的挑战分析一、低档产品封装产能过剩，高端产品的封装刚刚起步二、IC业“大进大出”的怪圈对封装业的成长提出了挑战三、我国IC的相关行业配套能力差，也对封装业造成不利影响四、技术相对滞后五、国内封装企业自我研发能力差、研发投入不足第四节 对发展我国IC封装业的思考 第六章 中国IC封装细分市场运行分析第一节 手机IC先进封装市场第二节 手机基频封装一、手机基频产业二、手机基频封装第三节 智能手机处理器产业与封装第四节 手机射频IC一、手机射频IC市场二、手机射频IC产业三、4G时代手机射频IC封装第五节 PC领域先进封装一、DRAM产业近况二、DRAM封装三、NAND闪存产业现状四、NAND闪存封装发展五、CPU GPU和南北桥芯片组 第七章 中国封装用材料运行分析第一节 金线第二节 IC载板 第八章 中国封装产业重点企业运行分析第一节 长电科技（）一、企业发展基本情况二、企业经

营状况分析三、企业竞争优势分析四、企业发展战略分析第二节 南通富士通微电子有限公司
一、企业发展基本情况二、企业经营状况分析三、企业竞争优势分析四、企业发展战略分析
第三节 安靠封装测试（上海）有限公司一、企业发展基本情况二、企业经营状况分析三、企
业竞争优势分析四、企业发展战略分析第四节 上海纪元微科电子有限公司一、企业发展基本
情况二、企业经营状况分析三、企业竞争优势分析四、企业发展战略分析第五节 沛顿科技（
深圳）有限公司一、企业发展基本情况二、企业经营状况分析三、企业竞争优势分析四、企
业发展战略分析第六节 浙江华越芯装电子股份有限公司一、企业发展基本情况二、企业经
营状况分析三、企业竞争优势分析四、企业发展战略分析 第九章 2022-2028年中国IC封装业前景
预测与投资战略分析第一节 2022-2028年中国IC封装业前景预测第二节 2022-2028年中国IC封
装投资战略分析一、IC封装业投资特性二、IC封装业投资机会与风险预测（ ）三、外资加大
中国市场投资影响分析四、投资建议 图表目录：图表：2015-2019年集成电路制造行业企业数
量增长趋势图图表：2015-2019年中国集成电路制造行业亏损企业数量及亏损面情况变化图图
表：2015-2019年集成电路制造行业累计从业人数及增长情况对比图图表：2015-2019年中国集
成电路制造行业销售收入及增长趋势图图表：2015-2019年中国集成电路制造行业毛利率变化
趋势图图表：2015-2019年中国集成电路制造行业利润总额及增长趋势图图表：2015-2019年中
国集成电路制造行业总资产利润率变化图图表：2015-2019年中国集成电路制造行业总资产及
增长趋势图图表：2015-2019年中国集成电路制造行业亏损企业对比图
更多图表见正文.....

详细请访问：<http://www.cction.com/report/202112/259906.html>